

Monikerroslevy, 26L HDI-piirilevy, FR-4

Tuotteen Kuvaus:

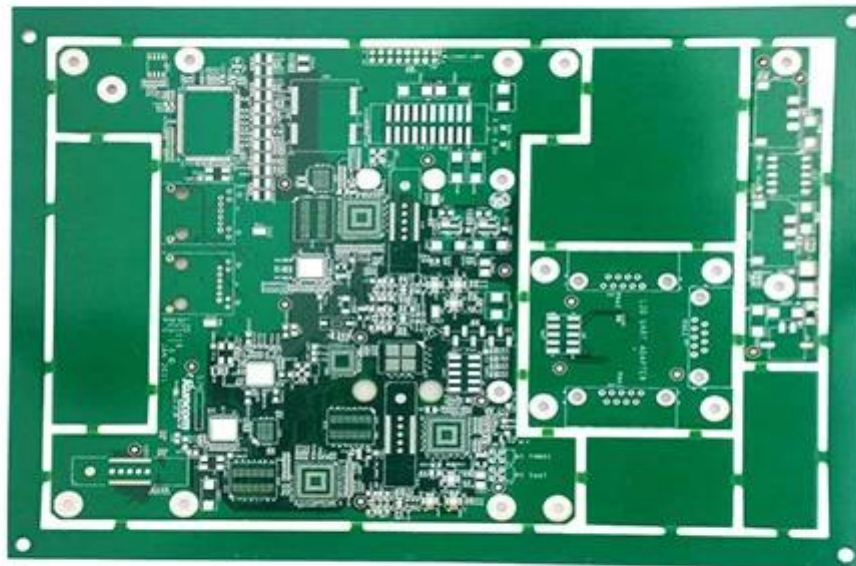
Lähtöisin	Guang dong, Kiina (Manner)	Tuotenimi	O-Johtavat
Pohjamateriaalia	NPG-150N	Kuparin paksuus	1oz
Min. Reiän koko	0.2mm	Min. Viivan leveys	2.35mil
Pinnan viimeistely sovelletaan	upotus kulta	Min. Riviväli	3mil
	Teollisuuden valvonta	merkki	Teollinen valvonta
toistukset	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
paino	0,01 kg -5 kg	MOQ	10kpl
Mallinumero	Power Bank PCB-kokoonpano pcba valmistaja	Hallituksen paksuus	0.1-5mm
väri-	vihreä	hinta	\$ 0,1- \$ 10
design tyyppi	asiakkaan vaatimus	koko	0.01m3-10m3

Pakkaus & Toimitus

Pakkaustiedot	16 vuoden ammattimainen OEM-asiakaslevyn valmistaja
Toimitustiedot	7-12 päivää

Tuotteen Kuvaus

erä	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte	tilavuus	Näyte
Kerroslaskenta	32	42	38	44	42	48
Minilähetys / tila (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Minin porausreikä halkaisija (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Kuvasuhde PTH: stä	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Mikä tahansa kerroksen yhteenliittäminen	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Levyn täyttö	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Min. ydinpaksuus (ei sisällä kuparia) (µm)	50	40	40	kolmekymmentä	40	kolmekymmentä
Min. Laserporan halkaisija (µm)	75	65	65	50	50	40
Via haudattu reikä / pinottu kautta	JOO	-	JOO	-	JOO	-
materiaali	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper jne.					
Sulautettu kondensaattori PCB	JOO	-	JOO	-	JOO	-
Pintaprosessi	Lyijytön HASL, ENIG, OSP, hopea upottamalla, upottamalla tina, Kultainen kulta, kultainen sormipäällyste, selektiivinen kiinteä kultainen päällyste, Hiutuva juotosmassiini, hiili inK					



www.o-leading.com

[HDI-piirilevy Printed circuit board](#)